

# AMCシリーズ

## 検査解析用の試料作製装置

SEM用断面観察試料を簡単に作製できます

シリコン・GaAs・SiC等の各種半導体基板、  
サファイア基板などに使用できます

断面試料作製のデモも行っています。



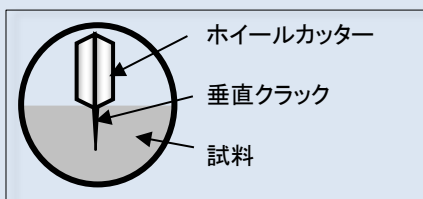
高性能ウェハ・マスク破断装置AMCシリーズは、タングステンカーバイドのローラーを用いた、SEM観察用断面試料を手軽に作製する為の装置です。ウェハ、マスクやTFTなどの欠陥箇所を検査する場合、欠陥箇所の断面試料を作製して高分解能SEMで観察を行います。AMCシリーズを使用すれば短時間で精度よく簡単に断面試料を作製することができます。

### 特徴

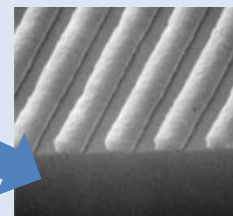
- ・最小±2.5 μmの位置精度でけがきが可能
- ・けがきの応力を利用した破断方法を採用
- ・観察部分へのけがきはスキップできる為、クリーンな断面を持った試料作製が可能
- ・けがき圧力の連続設定
- ・曲面試料であっても一定圧力のけがきが可能

### 加工プロセス

- ① モニターを見ながら  
けがき位置のティーチング
- ② 自動けがき開始
- ③ 観察部は自動スキップ
- ④ けがきによる内部応力を利用して試料を破断
- ⑤ 観察サイズに  
切り出し



AMCシリーズで作製した  
マスクガラスの破断面



\* AMCシリーズは高い位置精度でけがき線を引くための装置です。試料の破断はプライヤーなどで実施します。

\* 断面試料を作製する為には、結晶方位について考慮する必要があります。強化ガラスなどは試料作製が難しい場合があります。

\* 仕様・外観は予告なく変更することがあります。

## 仕様

シリーズ名	AMC-7800	AMC-8000
対象材料	各種半導体基板・サファイア基板等	
	最大φ8インチ 10mm厚	
ステージ移動距離	X=50mm Y=230mm θ=360°	
けがき位置精度	±15μm	±2.5μm
光学系	単眼ズーム顕微鏡	
画像系	CCD+液晶モニター	
照明装置	同軸落射照明	
表示倍率*1	約25~140倍	約75~400倍
電源	AC100V	
大きさ(mm)	445 <sup>W</sup> ×535 <sup>D</sup> ×620 <sup>H</sup>	550 <sup>W</sup> ×650 <sup>D</sup> ×570 <sup>H</sup>
概要重量*1	50kg	78kg
装置イメージ	 <p><b>AMC-7800</b> CCDカメラを搭載して操作性がUP</p>	 <p><b>AMC-8000</b> 最高機種(高いけがき位置精度)</p>

\*1 表示倍率は液晶モニターのサイズによって変化します。

\*2 AMC-7800 / 8000 の装置寸法・重量は本体のみでコントローラ、モニターなどを含みません。

## オプション

### 試料破断器

## ABK-5



**けがき加工を施した  
小さい試料・厚い試料の  
破断を補助します**

各種ウェハの他、特に厚さ3~5mmの  
ガラス試料の破断に効果を発揮します。

- 用途 : 各種半導体基板、マスクガラス、TFT基板など  
 加工手順 : ①弊社製品「高性能ウェハ・マスク破断装置AMCシリーズ」  
 などで、試料の表面にけがきを施します。  
 ②ABK-5にけがきを施した試料をセットします。  
 ③破断用ノブをゆっくり回して試料を破断します。

仕様 : サイズ 幅80×奥行140×高さ70mm  
 重量 約370g  
 対象試料厚 5mm以下

### ホイールカッター



タングステン カーバイド	105°
	120°
	135°
ダイヤモンド コーティング	105°
	120°
	135°

お客様の用途に合わせて6種類の刃を用意しています。

### ダブルライトガイド



AMCシリーズ付属の落射照明だけでは  
観察が難しい試料に対して有効です。